(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2012 年 12 月 13 日 (13.12.2012)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2012/167607 A1

(51) 国际专利分类号:
C09G 1/02 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2012/000763

(22) 国际申请日: 2012 年 6 月 4 日 (04.06.2012)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201110153087.2 2011 年 6 月 8 日 (08.06.2011) CN

(71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): **安集微电子（上海）有限公司 (ANJI MICROELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD)** [CN/CN]; 中国上海市浦东新区张江高科技园区龙东大道 3000 号 5 号楼 602 室, Shanghai 201203 (CN)。

(72) 发明人; 及

(75) 发明人/申请人 (仅对美国): **王晨 (WANG, Chen)** [CN/CN]; 中国上海市浦东新区张江高科技园区龙东大道 3000 号 5 号楼 602 室, Shanghai 201203 (CN)。 **何华锋 (HE, Huafeng)** [CN/CN]; 中国上海市浦东新区张江高科技园区龙东大道 3000 号 5 号楼 602 室, Shanghai 201203 (CN)。

(74) 代理人: **上海翰鸿律师事务所 (HANHONG LAW FIRM)**; 中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 1506-07 室, Shanghai 200002 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

根据细则 4.17 的声明:

— 关于申请人有权申请并被授予专利(细则 4.17(ii))

— 关于申请人有权要求在先申请的优先权(细则 4.17(iii))

— 发明人资格(细则 4.17(iv))

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

WO 2012/167607 A1

(54) **Title**: CHEMICAL-MECHANICAL POLISHING LIQUID

(54) **发明名称** : 一种化学机械抛光液

(57) **Abstract**: A chemical-mechanical polishing liquid comprising: polishing particles, water, an azole compound, and piperazine. The polishing liquid enables high-speed polishing of silicon, and the system has high stability and low comprehensive cost for semiconductor processing.

(57) **摘要**: 一种化学机械抛光液包含：研磨颗粒、水、唑类化合物和哌嗪。该抛光液实现了硅的高速抛光，且该体系具有非常高的稳定性，降低了半导体加工的综合成本。